

# 2012-2013年全球及中国先进封装行业研究报告

<2012-2013年全球及中国先进封装行业研究报告>包括以下内容：

- 1、全球半导体产业概况
- 2、IC制造产业概况
- 3、IC下游行业市场概况
- 4、先进封装产业与市场
- 5、23家先进封装厂家研究

2012年全球半导体销售额下滑了2.7%；半导体设备开支下滑了15%，从2011年的435亿美元下滑到了369亿美元。2013年的半导体市场也不容乐观，全球新兴经济体全面衰退，欧洲复苏乏力。美国和日本市场相对好一些，但作为全球最大半导体市场的中国，经济增速低于预期，全球经济仍然未出现复苏的迹象。

虽然半导体产业整体下滑，但在晶圆代工（Foundry）领域仍然呈现增长，2012年全球半导体晶圆代工市场总值达346亿美元，较2011年成长6.5%。随着智能手机、平板电脑增速放缓，预计2013年晶圆代工市场仅增长1.6%，约352亿美元以上。



先进封装厂家主要客户就是晶圆代工厂家，因此2012年先进封装厂家基本持平或微幅增长，预计2013年也是如此。黄金是先进封装厂家尤其是LCD Driver IC封装厂家必须使用的原材料，2013年金价下跌，将提高先进封装厂家的利润率。

位于马来西亚和新加坡的厂家都出现了下滑，因为这一地区的晶圆代工厂收入下滑。台湾厂家除内存封装外都有小幅度增长，主要是受益于TSMC、UMC的强力拉动。韩国企业则受益于三星的拉动。

日本企业J-devices增幅最大，主要是富士通将后端封装业务出售给了J-devices。2013年1月，日本最大的半导体厂家Renesas也将3座后端封装业务工厂出售给J-devices，2013年J-devices将会有惊人的增长，该公司预计2013财年收入超过1000亿日元，2017财年收入超过2500亿日元。

2013年表现会很好的还有台湾的Chipbond，该公司是全球最大的LCD Driver IC封装厂家。目前手机、平板电脑的屏幕分辨率（Resolution）都大幅度提升，这会大幅提高Chipbond的收入规模。黄金是Chipbond主要的原材料，金价下跌，Chipbond是最大受益者。为进一步完善产业链布局，2013年5月2日，Chipbond收购了COF Substrate厂家SIMPAL ELECTRONICS。

Chipbond还是营业利润率最高的先进封装厂家，其营业利润率在2011年是16.7%，2012年达到21.9%。也是唯一一家营业利润率增长的公司。ASE的营业利润率紧随Chipbond，主要因为其大客户TSMC制造的都是全球最顶尖的IC，ASE也因此具备较高的利润率。



中国大陆厂家表现不佳，JEET虽然收入大幅度增长，但是营业利润率大幅下跌，从2011年的1.8%跌至2012年的0.2%，处于亏损边缘。

### 2011-2012年全球前23大封测厂家收入与营业利润率

	企业总部所在地 (Headquarter Location)	2011	2012	2012 营 业利润率
ASE	台湾	4339	4387	21.6%
AMKOR	美国	2776	2760	5.5%
StatsChippac	新加坡	1707	1702	5.6%
SPIL	台湾	2078	2229	10.0%
PTI	台湾	1339	1435	11.9%
UTAC	马来西亚	958	908	
J-devices	日本	608	956	
ChipMOS	台湾	602	662	7.2%
JCET	中国大陆	582	703	0.2%
Chipbond	台湾	449	521	21.9%
KYEC	台湾	391	437	
FATC	台湾	402	367	5.3%
STS Semiconductor	韩国	407	489	4.7%
Unisem	马来西亚	380	375	10%
Carsem	马来西亚	332	282	
Signetics	韩国	243	306	7.8%
Hana Micron	韩国	258	235	1.1%
Nepes	韩国	242	312	11.7%
Walton Advanced Engineering	台湾	278	286	3.5%
Nantong Fujitsu Microelectronics	中国大陆	248	252	14.2%
Lingsen	台湾	198	200	11.6%
TIANSHUI HUATIAN	中国大陆	203	208	4.9%

单位：百万美元

来源：水清木华研究中心《2012-2013年全球及中国先进封装行业研究报告》



# 报告目录

## 第一章、全球半导体产业

### 1.1、全球半导体产业概况

### 1.2、中国IC市场

## 第二章、半导体产业格局

### 2.1、模拟半导体

### 2.2、MCU

### 2.3、DRAM内存产业

#### 2.3.1、DRAM内存产业现状

#### 2.3.2、DRAM内存厂家市场占有率

#### 2.3.3、移动DRAM内存厂家市场占有率

### 2.4、NAND闪存

### 2.5、复合半导体产业

## 第三章、IC制造产业

### 3.1、IC制造产业概况

### 3.2、晶圆代工

### 3.3、MEMS代工

### 3.4、中国晶圆代工产业

### 3.5、晶圆代工市场

#### 3.5.1、全球手机市场规模

#### 3.5.2、手机品牌市场占有率

#### 3.5.3、智能手机市场与产业

#### 3.5.4、PC市场

### 3.6、IC制造与封测设备市场

### 3.7、半导体材料市场

## 第四章、封测市场与产业

### 4.1、封测市场规模

### 4.2、封测产业格局

### 4.3、WLCSP市场

### 4.4、TSV封装

### 4.5、FLIP-CHIP

### 4.6、半导体测试

### 4.7、全球封测厂家排名

## 第五章、封测厂家研究

### 5.1、日月光





5.2、安靠Amkor

5.3、矽品精密SPIL

5.4、星科金朋

5.5、力成PTI

5.6、超丰Greatek

5.7、南茂科技ChipMOS

5.8、京元电子KYEC

5.9、Unisem

5.10、福懋科技FATC

5.11、江苏长电科技JECT

5.12、UTAC

5.13、菱生精密

5.14、南通富士通微电子

5.15、华东科技

5.16、颀邦科技Chipbond

5.17、J-DEVICES

5.18、MPI

5.19、STS Semiconductor

5.20、Signetics

5.21、Hana Micron

5.22、Nepes

5.23、天水华天科技



## 图表目录

- 1989-2016年全球IC市场规模
- 1990年4季度-2013年2季度全球半导体ASP
- 2011年1月-2013年3月半导体Book-to-Bill Ratio
- 1994-2012年全球晶圆产能变化
- 2011年全球前25大半导体厂家销售额排名
- 2012年全球前25大半导体厂家销售额排名
- 2011年模拟半导体主要厂家市场占有率
- 2011年Catalog 模拟半导体厂家市场占有率
- 2011年10大模拟半导体厂家排名
- 2011年MCU厂家排名
- 2008-2016年全球DRAM与NAND市场规模
- 2000-2013年DRAM产业CAPEX
- 2000-2013年全球DRAM出货量
- 2012年7月-2013年3月DRAM合约价涨跌幅
- 2010年1季度-2014年4季度DRAM Supply And Demand
- 2010年1季度-2014年4季度PC DRAM Supply And Demand



- 2009-2014年DRAM下游市场分布
- 2001-2013年 系统内存需求量
- 2011年4季度DRAM品牌厂商收入排名
- 2012年4季度品牌Dram厂商收入排名
- 2009-2011年Mobile DRAM 市场份额
- 2012年Mobile DRAM 市场份额
- 2012 年 品牌NAND Flash厂家市场份额
- 2009-2014年NAND下游市场分布
- GaAs产业链
- GaAs产业链主要厂家
- 2011-2012年全球GaAs厂家收入排名
- 2012年12月全球各地区Fab Installed Capacity by Minimum Geometry
- 2012年12月全球各地区Fab Installed Capacity by Product Type
- 2011年全球12英寸晶圆产能
- 2013全球12英寸晶圆产能
- 1999-2012年全球12英寸晶圆厂产能地域分布
- 2011年4季度-2012年4季度主要Fab支出产品分布
- 2010年1季度-2013年4季度全球晶圆加载产能产品分布



- 2010-2012年全球晶圆设备开支地域分布
- 2005-2012年全球Foundry销售额排名
- 2005-2012年全球主要Foundry运营利润率
- 2011年全球前30家MEMS厂家收入排名
- 2012年全球前20大MEMS Foundry排名
- 2011年中国Foundry销售额
- 2011年全球前25家IC设计公司排名
- 2008-2016年平均每部手机IC成本
- 2007-2014年全球手机出货量
- 2010-2013年全球CDMA/WCDMA手机出货量地域分布
- 2010-2011年每季度全球主要手机品牌出货量
- 2011-2012年全球主要手机厂家出货量
- 2012年4季度全球智能手机操作系统分布
- 2011-2012中国主要智能手机厂家出货量
- 2008-2013年全球PC用CPU与GPU 出货量
- 2012、2013年平板电脑主要厂家产量
- 2012-2014年 SE ASIA Fab分产品类型设备支出
- 2011-2014 SE Asia分产品产能





- 2007-2016全球晶圆设备投入规模
- 2011-2016年全球WLP封装设备开支
- 2011-2016年全球Die封装设备开支
- 2011-2016年全球自动检测设备开支
- 2011-2012年全球TOP 10 半导体厂家资本支出额
- 2013年全球TOP 10 半导体厂家CAPEX
- 2010-2013年全球半导体材料市场地域分布
- 2010-2012年全球半导体后段设备支出地域分布
- 2006-2014年OSAT市场规模
- 2007年全球IC封装类型出货量分布
- 2010年全球IC封装类型出货量分布
- 2012年全球IC封装类型出货量分布
- 2016年全球IC封装类型出货量分布
- 2007、2011、2015年全球封测市场技术分布
- 2012年全球OSAT产值地域分布
- 2014年全球OSAT产值地域分布
- 2007-2011年台湾封测产业收入
- 2010-2016年WLCSP封装市场规模



- 2010-2016年WLCSP出货量下游应用分布
- 手机CPU与GPU封装路线图
- 2012年FC封装下游市场分布
- 2002-2019年FC-BGA 技术趋势
- 2008-2012年全球前24大封测厂家收入与营业利润率
- 日月光组织结构
- 2005-2013年日月光收入与毛利率
- 2010-2012年日月光收入业务分布
- 2010年1季度-2011年4季度日月光铜线邦定收入
- 2010年1季度-2011年4季度日月光铜线邦定转换率
- 2010年1季度-2011年4季度日月光铜线邦定收入地理分布
- 2010年1季度-2011年4季度日月光铜线邦定 收入客户分布
- 2010年1季度-2013年1季度日月光封装部门收入、毛利率
- 2011年1季度-2013年1季度日月光封装部门收入类型分布
- 2010年1季度-2013年1季度日月光测试部门收入、毛利率
- 2010年1季度-2012年1季度日月光测试部门收入业务分布
- 2010年1季度-2013年1季度日月光材料部门收入、毛利率、运营利润率
- 2010年1季度-2013年1季度日月光 CAPEX与EBITDA



- 2012年1季度日月光10大客户
- 2013年1季度日月光收入下游应用
- 日月光中国分布
- 日月光上海封装类型
- 2004-2011年日月光上海收入
- 2005-2011年安靠收入与毛利率、运营利润率
- 2007-2012年安靠收入封装类型分布
- 2008年4季度-2012年4季度安靠收入封装类型分布
- 2008年4季度-2012年4季度安靠出货量封装类型分布
- 2011年安靠 CSP封装收入下游应用分布
- 2011年安靠 BGA封装收入下游应用分布
- 2011年3季度安靠 Leadframe封装收入下游应用分布
- 2011年3季度安靠收入与出货量地域分布
- 2012年安靠收入与出货量地域分布
- 2008年1季度-2013年1季度安靠封装业务产能利用率
- 2011年1季度-2013年1季度Amkor收入下游市场分布
- 2011-2012年安靠成本结构
- 矽品精密工业组织结构



- 2003-2013年矽品收入、毛利率、运营利润率
- 2011年3月-2013年3月矽品月度收入与增幅
- 2005-2012年4季度矽品收入地域分布
- 2005-2012年4季度矽品收入下游应用分布
- 2005-2012年4季度矽品收入业务分布
- 矽品2006年1季度、2007年2、3季度、2011年3、4季度产能统计
- 2011年3季度-2012年4季度Copper/Ag Alloy 季度收入
- 2004-2013年星科金朋收入与毛利率
- 2006-2012年1季度星科金朋收入封装类型分布
- 2006-2013年1季度星科金朋收入下游应用分布
- 2006-2013年星科金朋收入 地域分布
- 2006-2013年力成科技收入与运营利润率
- 2011年3月-2013年3月力成科技月度收入与增幅
- 力成科技工厂一览
- 力成科技的TSV解决方案
- 2012年4季度力成科技收入业务分布
- 2012年4季度力成科技收入产品分布
- 2005-2013年超丰电子收入、毛利率、运营利润率



- 2007-2010年超丰电子收入技术类型分布
- 2011年3月-2013年3月超丰电子月度收入与增幅
- 2003-2013年南茂科技收入与毛利率
- 2010-2012年南茂科技收入业务分布
- 2010-2012年南茂科技收入产品分布
- 2009-2012年南茂科技Utilization Rate 和EBITDA Margin
- 2009-2012年南茂科技Cash Flow 和CAPEX
- 2011年南茂科技收入客户分布
- 2006-2011年南茂科技收入地域分布
- 2002-2013年京元电子收入与毛利率
- 2011年3月-2013年3月京元电子月度收入
- 京元电子厂房分布
- 京元电子TESTING PLATFORMS
- 2006-2013年Unisem收入与EBITDA
- 2010年1季度-2012年4季度 Unisem收入与EBITDA
- 2012年Unisem收入产品分布
- 2012年Unisem收入市场分布
- 台塑集团组织结构





- 福懋科技组织结构
- 2006-2013年福懋科技收入与运营利润率
- 2011年3月-2012年3月福懋科技月度收入
- 2006-2013年JECT收入与运营利润率
- 2011-2012年JECT产量、销量
- 2011-2012年JECT 测试成本结构
- 2011-2012年JECT 封装成本结构
- JCET路线图
- 2011年JCET收入地域分布
- 2007-2013年菱生精密收入与运营利润率
- 2011年3月-2013年3月菱生精密月度收入
- 2006-2011年南通富士通微收入与增幅
- 2006-2011年南通富士通微净利润与增幅
- 2006-2011年南通富士通微季度收入与增幅
- 2006-2011年南通富士通微季度净利润与增幅
- 2006-2011年南通富士通微季度毛利率
- 2006-2011年南通富士通微季度A、S、R&D
- 2007-2013年华东科技收入与运营利润率



- 2011年3月-2013年3月华东科技月度收入与增幅
- 2006-2013年硕邦科技收入与运营利润率
- 2011年3月-2013年3月硕邦科技月度收入与增幅
- 2012年硕邦科技收入业务分布
- 2009年4季度-2012年1季度欣邦收入产品分布
- 2012年硕邦科技收入市场分布
- J-Devices 组织结构
- 2007-2013财年MPI收入与税前利润
- MPI收入地域分布
- Carsem 2011年1季度-2012年1季度收入产品分布
- STS Semiconductor组织结构
- 2006-2013年STS Semiconductor收入与运营利润率
- 2012年1季度-2013年4季度STS Semiconductor收入产品分布
- Signetics股东结构
- 2007-2013年Signetics收入与运营利润率
- 2010年1季度-2012年4季度 Signetics产能利用率 (Utilization) 与运营利润率
- 2011年Signetics收入产品分布
- 2011年Signetics收入客户分布

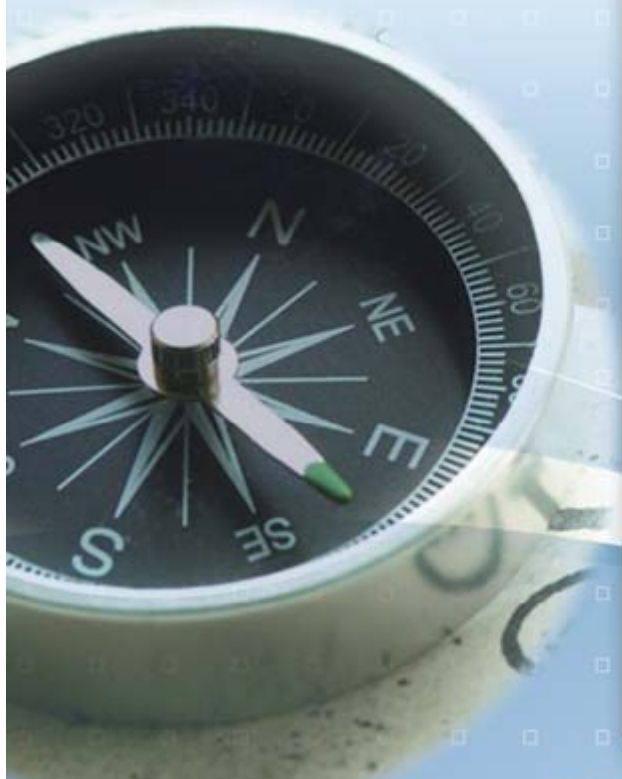


- 2012年1季度-2013年4季度 Signetics收入技术分布
- 2006-2013年Hana Micron收入与运营利润率
- 2011年Hana Micron收入客户分布
- 2012年1季度-2013年4季度Hana Micron收入市场分布
- 2007-2013年Nepes收入与运营利润率
- 2012-2013年Nepes季度收入与运营利润率
- 2012-2013年Nepes季度收入部门分布
- 2006-2013年天水华天收入与运营利润率



# 购买报告

价 格	电子版：8500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：9000元	传真：010-8260.1570
页数：162页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2013-04		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201305/24511631.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201305/24511631.html</a>		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		



# 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570



# 版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

